

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。自2026年行动方案发布以来，公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。

2026年8月12日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，根据2026年上半年公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告，具体如下：

一、行动方案相关措施的实施情况及效果

（一）聚焦经营主业，深耕先进封装

公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测

试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

今年上半年，受下游显示面板呈现结构性变化及终端产品需求波动影响，公司DDIC封测业务在一定程度上承压，报告期内整体呈现触底回升态势。同时，为顺应先进封装技术向2.5D/3D与异质集成演进的行业趋势，把握AI基础设施建设带动的先进封装需求，持续提升公司价值，公司正积极布局HITS先进封装技术平台，打造新的增长曲线。报告期内，公司营业收入同比增长10.67%，达9.59亿元；2026年第二季度单季营收规模创公司历史新高，达5.48亿元。报告期内，受黄金等原材料价格大幅上涨、一季度订单不饱和推高单位成本、终端产品结构性变化、研发投入及股份支付费用、存货跌价损失增加、美元贬值产生汇兑损失等多重因素影响，上半年归属于上市公司股东的净利润为501.23万元，同比减少94.78%。后续，公司将不断降本增效并拓展市场以提升产能利用率，积极修复并提升整体盈利能力。

围绕先进封装主营业务，报告期内公司各项重点工作稳步推进：

1、推进铜镍金和钯金等新型凸块制程产能建设，满足客户需求

近年来金价大幅上涨导致部分IC设计公司调整芯片封装业

务需求，由传统金凸块制程逐步转型铜镍金、钯金等凸块制程，减少芯片封装环节黄金耗用量，从而实现芯片封装环节的降本增效。公司立足客户需求，基于在金凸块制程多年量产工艺中积累的深厚技术优势，投入研发并建设铜镍金、钯金等新型凸块制程产能。报告期内，公司已完成建制每月数千片的新型凸块制程产能，未来还将视客户需求及产业趋势适时扩大新型凸块产能规模，以满足客户在芯片封装环节的降本增效诉求。

新型凸块制程相比于金凸块，含金化学品使用量有所减少，客户承担的材料成本降低，但以加工服务费衡量的制程收费价格并不低于金凸块制程，开发新型凸块制程在一定程度上有助于提升公司整体毛利率。报告期内铜镍金凸块产能实现稳步提升，新增产能的有效释放，不仅进一步优化了公司的制程结构与产品矩阵，还降低了客户承担的成本，大幅提升了公司在高端显示驱动芯片及其他高附加值产品领域的交付能力与市场竞争力，持续扩大了公司在显示驱动芯片封测领域的综合竞争力。

2、大力开拓市场，深化客户合作与全球化布局

芯片设计公司客户甚至是下游面板环节对于显示驱动芯片封测厂商的良率、品质、产能以及交货及时性都有着较为严格的要求，封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成合作意向及下单，并在此基础上持续进行品质稽核，经过验证能够稳定满足客户要求才有可能放量。客户资源在显示驱动芯片封测领域向来至关重要。

报告期内，公司通过加强品质管控以及为客户提供个性化

服务，凭借灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力赢得了更多知名客户的认可和信任，市场份额有所上升，特别是 AMOLED DDIC 领域具备领先优势的龙头厂商。

3、加快HITS平台建设，深化先进封装前沿技术研发布局

报告期内，为顺应集成电路产业向2.5D/3D与异质集成演进的趋势，公司加速推进HITS技术平台的产线规划与核心技术攻坚。在高端智能终端领域，AI赋能下智能手机、AI PC、智能穿戴等设备快速迭代，对芯片微型化、低功耗、高带宽、超薄形态的要求持续升级。HITS技术平台依托晶圆级平面整合技术，可将算力核心SoC、存储LPDDR及Wi-Fi等核心组件集成于单一微型封装内，有效降低设备功耗、提升信号传输效率，全面适配下一代AI终端的迭代需求，助力终端产品完成结构性换机升级。

（二）保持研发投入，培育创新土壤

报告期内公司持续加大在集成电路先进封装测试等领域的研发力度，在营业收入稳步增长创出同期新高的情况下研发投入总额占营业收入比例小幅增长，研发投入同比增加16%达5,965.60万元。知识产权方面，报告期内公司新获发明专利3项、实用新型专利14项，截至报告期末，公司累计获得发明专利54项、实用新型专利449项、软件著作权3项。

（三）完善公司治理，强化合规意识

2026年上半年，公司持续强化合规治理体系建设，紧密关

注法律法规和监管政策变化，严格按照中国证监会规定及《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善公司治理结构，健全内控制度，适时修订《公司章程》及其他公司治理制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司治理水平迈上新台阶。此外，公司在上半年委托律师事务所面向董事、高级管理人员以及其他核心员工举办内幕信息与内幕交易合规培训，有效提升公司关键少数内幕信息保密意识、股票交易合规意识。

因未及时履行关联交易审议和披露程序，2026年5月公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对合肥新汇成微电子股份有限公司采取出具警示函措施，对郑瑞俊、闫柳、奚颶采取监管谈话、出具警示函措施的决定》（〔2026〕26号），决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，对董事长兼总经理郑瑞俊、财务总监闫柳、董事会秘书奚颶采取监管谈话、出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。2026年5月14日，上海证券交易所出具《关于对合肥新汇成微电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，因未及时履行关联交易审议和披露程序，对公司、董事长兼总经理郑瑞俊、财务总监闫柳、董事会秘书奚颶予以通报批评。

公司通过自查方式发现存在关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务的问题后，及时全面梳理关联方识别以及关联交易的整体情况，果断决定及时纠错，于2026年3月19日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事

会第十七次会议审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》，关联董事依法依规回避表决。董事会补充审议后，公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站披露了《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。因公司与苏州芯璞对鑫丰科技增资之关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000.00万元，达到了股东会审议标准，《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》提交公司2025年年度股东会审议并于2026年4月9日获得股东会补充确认。

公司对此高度重视，将以此持续警醒关键少数人员持续学习证券法律法规，不断强化合规意识，举一反三，全面排查公司在治理层面是否存在其他缺陷，进一步提升公司治理水平。

（四）提高信息披露质量，加强投资者沟通

1、严格落实信息披露工作，提高信息披露质量

2026年上半年，公司加强信息披露管理工作，完善信息披露内部控制程序，健全自查自纠和多人复核机制，及时、合规地公开披露投资者关切的经营情况和重大事项。信息披露各项工作平稳运行，在真实、准确、完整、及时披露公司定期报告、临时公告的同时，信息披露质量和透明度有所提升，不存在重大差错或者重大遗漏，维护了股东特别是社会公众股东的合法权益。

2、完善多层次投资者沟通渠道，提振投资者信心

公司常态化、高效地组织定期报告业绩说明会，在保障董事（含独立董事）和高级管理人员的高参与度和回复率的同时，向投资者全面介绍公司业绩，并积极回复投资者的问题。2026年4月1日公司在价值在线平台线上召开了2025年度业绩暨现金分红说明会，通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通，及时向投资者介绍公司行业趋势、公司经营、财务指标以及现金分红情况，并就相关问题进行解答。

公司始终保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，在维护股东知情权和遵守监管合规要求的前提下合理回应“上证e互动”提问，完善投资者来电接听工作机制，耐心倾听投资者诉求，对投资者在电话中关心的重点问题进行详细解答，增强信息披露可理解性，提高公司透明度。

（五）践行股东回报，创造长期价值

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。

2026年5月20日，公司按照股东会审议通过的利润分配方案完成权益分派实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），以方案实施前的公司总股本990,938,171股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利

49,546,908.55元，回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销金额合计49,546,908.55元，实际派发现金红利49,546,908.55元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.02%，较好地兼顾了投资者回报和公司发展资金留存需求。

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司决定使用自有资金以及和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）回购股份用于员工持股计划或股权激励。截至2026年7月31日，公司已完成本次股份回购，累计回购公司股份500万股，支付的资金总额为人民币11,109.64万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（六）强化激励约束机制，共享发展成果

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求。公司将核心人才视为企业最宝贵的资本，努力打造细分行业内全球一流的研发和管理团队。报告期内，公司持续落实人力资本战略，不断完善长效激励体系与共享机制，以坚定发展信心，进一步吸引和留住国内外高端研发与管理人才，为公司向先进封装领域的高质量转型提供了坚实的人才底座保障。

二、投资者关于改进行动方案的意见建议

无。

三、进一步改进措施

2026年上半年，公司扎实推进行动方案的全面落地，在运营效率提升、市场竞争力增强、分红和回购回报投资者等方面均取得了阶段性成果，为公司长远稳健发展奠定了坚实基础。展望未来，公司将继续深化各项既定战略举措，进一步聚焦集成电路封装测试主营业务，不断完善公司在显示、存储、算力三大应用领域封装测试布局；同时，通过良好的盈利能力、经营质量和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，持续向高质量发展迈进。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此报告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年8月12日